

Bonder注意事項

1. 晶圓表面不可為整面的金屬層或有機物質，需為氧化層或其它絕緣層，且不可有表面脫膜的情形。
2. 請留意晶圓是否有bending情形，可能會在鍵合製程中破裂。
3. 不同基板材料的鍵合不可做post annealing製程，避免加熱後晶片破裂。
4. 晶圓表面的粗糙度和潔淨度會影響鍵合結果的成敗。